上海移远通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

上海

2026 年 11 月

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 2
2026 年第一次临时股东会会议议程 4
2026 年第一次临时股东会会议议案 6
议案一 《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》 6
议案二 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 8

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前出席会议的，可以参加表决；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后出席会议的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、参会人员须配合工作人员安排，共同维护会场秩序。会议期间请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复和说明。对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理解。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主

持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2026 年 11 月 9 日 15:00

地点：上海移远通信技术股份有限公司,上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号（横港路 288 弄 1-5 号）

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2026 年 11 月 4 日

三、现场会议安排

（一） 主持人宣布出席本次股东会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东会开始；

（二） 推举计票人、监票人，发放表决票；

（三） 审议各项议案；

（四） 股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问；

（五） 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（六） 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（七） 宣布投票表决结果及股东会决议；

（八） 见证律师宣读法律意见书；

（九） 董事签署会议决议和会议记录；

（十） 主持人宣布会议结束。

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一 《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的议案》。公司以利润分配方案实施前的总股本 287,823,419 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 115,129,368 股，转增后公司总股本为 402,952,787 股。公司已于 2026 年 6 月 1 日实施完成 2025 年度利润分配方案，公司总股本由 287,823,419 股变更为 402,952,787 股，注册资本由人民币 287,823,419 元变更为 402,952,787 元。

公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为 4,132,968 份，可行权期为 2026 年 7 月 3 日-2027 年 1 月 23 日。2026 年 7 月 3 日-2026 年 9 月 30 日期间，公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期各激励对象累计行权并完成股份过户登记数量为 3,408,807 股。因此，截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本由 402,952,787 股变更为 406,361,594 股，注册资本由人民币 402,952,787 元变更为 406,361,594 元。

综上，公司总股本由 287,823,419 股变更为 406,361,594 股，注册资本由人民币 287,823,419 元变更为 406,361,594 元。

公司因经营发展需要，拟将注册地址由上海市松江区泗泾镇横港路 288 弄 1-5 号变更为上海市松江区泗泾镇横港路 288 弄 1 号 101 楼 1 层。

鉴于公司上述注册资本、股份总数、注册地址变化及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2026 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-062）和《公司章程》（2026 年 10 月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

议案二 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东及股东代理人：

为加快募集资金的投资进度，提升募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司拟优化调整募集资金投向，将原“车载及 5G 模组扩产项目”变更为“5G 模组扩产项目”和“先进封装制造项目”。公司计划就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司借款的方式实施新项目，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）核准，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海移远”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股，实际募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元，募集资金已于2025年12月12日到账。

（二）募投项目投资计划及实际投入情况

截至 2026 年 8 月 31 日，公司募投项目投资计划及实际投入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

募投项目名称	募集资金拟投资金额	已使用募集资金金额	达到预定可使用状态时间	项目进度（%）
车载及5G模组扩产项目	92,489.65	28,813.54	2027 年 9 月	31.15
AI算力模组及AI解决方案产业化项目	39,733.20	11,772.50	2027 年 9 月	29.63

总部基地及研发中心升级项目	51,352.44	24,716.74	2027 年 9 月	48.13
补充流动资金项目	38,417.32	38,417.42	-	100
合计	221,992.61	103,720.21	-	-

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资情况

公司原募投项目为“车载及5G模组扩产项目”，项目实施主体为公司全资子公司常州移远通信技术有限公司及赣州移远科技有限公司。项目计划投资总额为92,489.65万元，全部使用募集资金投入，其中建设投资89,043.23万元，计划达到可使用状态时间为2027年9月，项目建成后预计内部收益率为10.40%。截至2026年6月30日，“车载及5G模组扩产项目”已投入募集资金金额23,352.22万元，已实现效益3,888.94万元。本次募投项目变更是为加快公司募集资金投资进度，提升募集资金使用效率，原“车载及5G模组扩产项目”已形成的资产将继续正常运营。

（二）变更的具体原因

1、变更原“车载及 5G 模组扩产项目”的原因

根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2024年全球乘用车销量为6,748.69万辆，同比增长3.17%，2025年全球乘用车销量为7,097.47万辆，同比增长5.2%。根据中汽协（CAAM）数据，2024年我国乘用车销量为2,756.3万辆，同比增长5.8%，2025年我国乘用车销量为3,010.3万辆，同比增长9.2%，2024年和2025年的乘用车出货量增速稳健。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据，2026年上半年全球新车注册量3,570万辆，同比下降4.9%。根据中汽协（CAAM）数据，2026年前三季度我国乘用车销量为1,996万辆，同比下降6.1%。

根据上述行业数据显示，2024-2025年，乘用车出货量增速稳健。2026年整

车出货量增速有所放缓，公司“车载及5G模组扩产项目”立项于2025年3月，该项目系根据立项时的行业发展态势进行的规划，符合当时的行业发展情况。2026年前三季度车载模组市场需求及竞争格局未出现重大变化，但考虑到全球乘用车市场需求放缓趋势，本着谨慎投资、提高募集资金使用效率的原则，经公司综合评估，公司拟不再使用募集资金投入车载模组产线扩产，后续将根据市场需求变化情况，适时以自有资金逐步投入。面对乘用车出货量增速放缓的市场环境，公司不断拓展车载产品品类，通过全域产品布局，强化整体方案的落地支撑能力，提升单车搭载价值量驱动车载业务持续发展。

2、变更为“5G 模组扩产项目”和“先进封装制造项目”的原因

据爱立信《移动市场报告》，2025年全球物联网连接总数约223亿，预计2031年增至471亿，年均复合增长率约13.3%；蜂窝物联网连接数将由45亿增至78亿，年均复合增长率约9.6%，其中宽带及关键物联网（4G、5G）仍是主流，截至2025年底，该类连接数约达26亿，为5G深度渗透物联网奠定基础。根据ABI数据，全球蜂窝模组出货量预计将从2025年的5.09亿增至2030年的8.42亿，年均复合增长率约11%，其中5G模组出货量预计将从2025年的0.21亿增至2030年的2.03亿，年均复合增长率约57%。根据Mordor Intelligence数据，全球5G专网市场规模预计将由2026年的43.5亿美元增长至2031年的252.5亿美元，年均复合增长率约42%。随着全球5G网络的快速普及以及公司在无线通信模组领域的市场份额的持续增长，为更好地满足市场需求和服务客户，公司持续进行5G模组产能建设，持续巩固公司在产业链和供应链的市场地位。因此，公司将部分募集资金用于实施“5G模组扩产项目”。

随着5G、物联网、卫星通信、人工智能及边缘计算等技术持续发展，终端设备需要同时兼容多通信制式、多频段，集成感知、定位、算力与无线传输等复合

功能，模组产品正向小型化、高集成度、低功耗、高射频性能与高可靠性方向演进。传统封装方案采用分立器件贴装于PCB基板，器件之间占用大量基板面积，长距离板级走线带来信号损耗、寄生参数、电磁干扰与信号完整性难题，多器件BOM与SMT贴装工序也推高物料成本与良率管控难度，难以适配终端持续压缩的结构空间。

先进封装是以异构集成为核心的高密度互连技术体系，包含SiP系统级封装、倒装（Flip Chip）等技术路线，可将应用处理器、存储芯片、射频收发芯片、功率管理芯片，连同滤波器、电感、电容等无源器件，在单一封装体内完成共集成，实现完整系统或子系统功能。相比传统分立板级方案，先进封装透过微米级高密度互连，大幅压缩器件互连距离，减少PCB板级走线数量，降低信号传输寄生阻抗、射频插入损耗与IR压降，改善高频信号完整性；同时缩小模组整体占位面积与厚度，实现整机小型化。

从技术底层价值看，先进封装支持不同工艺节点、不同材料体系芯片的异构整合，能够灵活选用成熟工艺射频芯片、先进工艺算力芯粒与存储器件组合，大幅降低单片流片成本、缩短新品开发周期，提升器件选型与产品配置的弹性。在射频通信场景下，屏蔽结构与一体化无源集成，可优化多频段隔离度，抑制串扰，满足5G、卫星通信等高频段严苛的射频指标；针对端侧AI与边缘计算，短互连路径带来更高数据吞吐、更低动态功耗，缓解算力模组的功耗瓶颈；同时封装级一体化设计可同步开展热仿真、应力仿真，优化散热路径，提升高低温循环、湿热、振动等环境下的长期可靠性，满足工业、卫星终端等严苛应用标准。

因此，先进封装不再只是芯片后道封装工序，而是实现系统性能提升的核心技术抓手，是适配终端设备小型化、多功能化、快速迭代需求的关键技术路径，可广泛落地于射频通信、无线连接、高精度定位、端侧智能等各类模组产品，支

撑下一代多模智能终端的产品竞争力构建。

随着物联网终端向小型化、集成化及多功能化方向发展，下游客户对模组产品的集成度、性能、可靠性及交付稳定性提出了更高要求。使用先进封装技术的模组产品集成器件数量较多，产品开发及量产涉及封装设计、工艺验证、测试认证等多个环节，需要模组企业加强研发设计与生产制造之间的协同，并持续提升产品质量控制、需求响应和稳定交付能力。根据Yole发布的《Status of the Advanced Packaging Industry 2026》，2025年全球先进封装市场规模为550亿美元，预计2031年将增长到超过1,090亿美元，2025年-2031年年复合增长率（CAGR）约12.08%。

基于上述行业发展趋势及持续增长的市场需求，随着5G/AIoT、可穿戴设备及边缘计算等下游应用快速迭代，终端产品对通信模组在小型化、高频高速、多功能融合及低功耗方面的要求持续提升，传统引线键合与单一芯片封装路线已难以满足多传感器、多协议通信、高算力集成在有限空间内的协同部署。公司作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，现有模组产品在工艺制程上仍以外协封装为主，存在先进封装产能受制于供应链、设计—制造协同周期长、核心工艺数据不透明、成本优化空间受限等瓶颈。

为此，公司需持续深化SiP系统级封装、倒装等先进封装技术在模组产品中的导入应用，进一步提升模组产品的小型化水平、集成度及功能承载能力，构建覆盖“设计—工艺验证—批量制造”的先进封装自主能力体系。“先进封装制造项目”的实施，一方面有利于公司将先进封装工艺进一步应用于现有蜂窝模组、智能模组等产品线，通过异构集成将主控芯片、存储、射频前端、电源管理及传感器等多裸片在单一封装体内协同布局，显著缩减PCB占位面积、缩短互连路径、降低信号损耗，并提升产品可靠性与量产一致性；另一方面，自主制造能力的建

成将强化公司在封装设计规则、工艺窗口与良率爬坡上的自主可控，缩短新品从研发到量产的交付周期，形成“模组设计—先进封装—整机应用”的垂直协同壁垒，更好适应下游终端设备小型化、高集成度及多功能融合的发展需求，为公司在高附加值模组及工业等高可靠场景的市场拓展提供坚实的制造底座。

综上所述，为加快募集资金的投资进度，提升募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟优化调整募集资金投向，将原“车载及5G模组扩产项目”变更为“5G模组扩产项目”和“先进封装制造项目”。

三、新项目的具体内容

（一）5G 模组扩产项目

1、项目基本情况

项目名称：5G模组扩产项目

实施地点：上海市；江苏省常州市；江西省赣州市

实施主体：上海移远通信技术股份有限公司；常州移远通信技术有限公司；赣州移远科技有限公司

建设内容：项目计划通过租赁生产厂房，购置SMT等生产设备、测试设备、检测设备及配套设备，并引进生产技术及管理人员，建成5G模组智能制造生产线。

项目审批：本事项尚需经公司股东会审议。待公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目相关的备案或审批手续。

2、项目投资计划

本项目拟投资总额为53,902.17万元，其中拟使用募集资金投入51,891.45万元。项目建设期预计为18个月，经预测分析，本项目具有良好的经济效益，税后内部收益率为12.96%，回收期为8.91年（该预计内部收益率不代表公司的盈利预

测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在不确定性）。

具体项目投资计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	投资内容	投资金额	占总投资比例（%）
一	建设投资	50,399.20	93.50
1	场地投入	8,334.25	15.46
2	设备投入	39,664.99	73.59
3	基本预备费	2,399.96	4.45
二	铺底流动资金	3,502.97	6.50
三	项目投资总额	53,902.17	100.00

3、项目实施的可行性

（1）公司拥有完善的营销体系和优质的客户资源

为了更好地服务客户并提升市场响应速度，公司在亚太、欧洲、北美等重点区域设立了直营办事处，开展属地化营销和服务。目前，公司销售网络已覆盖中国、欧洲、北美和亚非拉等150多个国家和地区，客户遍布全球。凭借出色的产品性能和服务能力，公司在行业内树立了良好的口碑，与国内外客户建立了长期稳定的合作关系。公司5G模组产品广泛应用于工业自动化、远程医疗、智慧能源等多个场景。

（2）公司具有优秀的生产管理能力

公司现具备自动化SMT贴片、可靠性测试等先进制造能力，能够高效完成从原材料到成品的全流程生产。公司运营部拥有一支经验丰富的供应链管理团队，能够有效协调和管理从原材料采购到产品配送的各个环节，确保供应链高效运转。公司已通过多项国际权威管理体系认证，包括ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，确保产品满足高可靠性和安全性的严格要求。

综上，公司完善的营销体系、优质的客户资源、优秀的生产管理能力为本项目顺利实施提供保障，本项目投资效益优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。

（二）先进封装制造项目

1、项目基本情况

项目名称：先进封装制造项目

实施地点：上海市；江苏省常州市；江西省赣州市

实施主体：上海移远通信技术股份有限公司；常州移远通信技术有限公司；赣州移远科技有限公司

建设内容：项目拟购置生产、检测及测试设备，建设先进封装生产线，以提高射频前端先进封装、Wi-Fi通信先进封装、GNSS定位先进封装及AI运算先进封装等产品的生产制造能力。

项目审批：本事项尚需经公司股东会审议。待公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目相关的备案或审批手续。

2、项目投资计划

本项目拟投资总额为43,039.77万元，其中使用募集资金投入38,587.48万元。项目建设期预计为24个月，经预测分析，项目具有良好的经济效益，税后内部收益率为13.64%，回收期为7.92年（该预计内部收益率不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在不确定性）。

具体项目投资计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	投资内容	投资金额	占总投资比例（%）
一	建设投资	40,647.94	94.44

1	场地投入	7,706.97	17.91
2	设备投入	31,005.35	72.04
3	基本预备费	1,935.62	4.50
二	铺底流动资金	2,391.84	5.56
三	项目投资总额	43,039.77	100.00

注：上表中加计尾差系四舍五入所致。

3、项目实施的可行性

（1）公司具备项目实施所需的技术研发及产品产业化基础

截至2026年6月末，公司拥有研发技术人员6,693人，占员工总数的65.99%；2026年1-6月，公司研发投入为12.28亿元，占同期营业收入的8.05%，同比增长39.25%。公司在上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城及马瑙斯设有九大研发中心，为技术研发及产品开发提供了人员和资源支持。

在先进封装技术方面，公司引进了具有国际知名半导体企业从业经历的专业技术团队，团队覆盖研发、制程、设备、工艺整合及产品工程等环节，核心成员具备先进封装产品研发和规模量产经验，为本项目从0到1的产线搭建提供关键人才支撑。围绕本项目SiP、FC-BGA等产品方向，团队正同步开展多芯片异构集成、细间距倒装键合、高多层基板翘曲控制、模组电磁屏蔽及热管理、大尺寸FC-BGA底部填充可靠性控制等方面的技术积累，并在进行屏蔽罩贴装、无源元器件高密度贴装、异质芯片堆叠组装，以及FC-BGA产品的倒装键合、铜柱凸点、底部填充、非导电胶膜贴合、植球和基板级组装等关键技术的工艺开发，全面支撑本项目工艺开发、设备导入、生产线建设及量产爬坡。

（2）下游应用及先进封装市场发展为项目实施提供市场基础

近年来，随着人工智能、高性能计算、云计算等下游领域快速发展，全球算力芯片市场规模持续增长。算力芯片性能和集成度持续提升，对芯片系统的互连密度、存储带宽、功耗及散热能力提出了更高要求；与此同时，通信模组、物联

网设备、智能终端及可穿戴设备持续向小型化、高集成度、低功耗和多功能融合方向发展，对芯片及元器件的封装密度、产品尺寸和可靠性提出了更高要求。在上述需求推动下，先进封装的功能由传统的芯片保护和电气连接，逐步向高密度互连、异构集成、系统级集成及系统性能优化方向发展，其应用领域也由消费电子进一步拓展至人工智能、高性能计算、通信和物联网等领域。未来，随着多芯片集成、异构集成封装及三维堆叠等技术持续发展，先进封装在提高系统集成度、改善互连效率、优化功耗和实现产品小型化等方面的作用将进一步增强，并逐步成为支撑芯片性能提升和终端产品集成化发展的重要技术路径。

在下游需求增长和封装技术持续演进的推动下，全球先进封装市场预计保持增长。根据Yole发布的《Status of the Advanced Packaging Industry 2026》，2025年全球先进封装市场规模为550亿美元，预计2031年将增长到超过1,090亿美元，2025年-2031年年复合增长率（CAGR）约12.08%。

（3）公司具备项目实施所需的生产运营及质量管理基础

公司已形成覆盖研发、制造、测试认证及客户服务等环节的全球化运营体系。在制造方面，公司形成“自有工厂+合作代工”的弹性供应体系，目前布局常州、赣州、临沂和马来西亚自有工厂，并与全球多地代工厂开展合作，能够根据业务需求统筹配置产能并增强供应链稳定性。

在测试和质量管理方面，公司依托全球超过15,000平方米的实验室、18,000余台测试设备及超过9,300项全球认证，构建了覆盖产品测试、认证及质量管控的能力体系。先进封装产品涉及器件集成、工艺验证、可靠性测试及规模生产等多个环节，公司现有实验室、测试设备及认证经验能够为本项目产品的测试验证和质量管理提供支持。此外，公司已形成模组及天线、端侧AI及解决方案、物联网垂直解决方案等多元业务协同发展的布局，并积累了跨区域研发、制造和客户

服务经验。

综上，下游应用及先进封装市场的发展为本项目实施及相关产品的市场拓展提供了良好的市场基础；本项目投资效益优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值；公司具备实施本项目所需的生产运营和组织管理基础，本项目在组织实施方面具有可行性。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层具体办理募投项目变更相关事宜。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2026 年 11 月 9 日